

PEST 分析レポート：電子部品製造業 (2025 年-2030 年予測含む)

【P】政治的要因 (Political)

- 地政学リスク：米中関係の緊張、台湾情勢、ロシア・ウクライナ戦争の長期化などが電子部品の原材料供給網に直接影響を及ぼす可能性がある。
- 中央政府補助金：経済安全保障法案による半導体製造への投資誘導と地方企業への波及効果。
- 地方自治体政策：地方創生やリスクリング支援策が工場誘致や人材確保に貢献する可能性。
- 関税政策：米国の対中制裁やインド・ASEAN との EPA 改定が、部材調達コストや輸出入構造に変化をもたらす。
- 政治的空気感：経済安保の流れの中で「国産化回帰」が加速し、国内製造回帰への期待とプレッシャーが高まる。

【E】経済的要因 (Economic)

- 為替の影響：円安傾向が続けば、輸出には有利だが原材料コスト上昇の圧力。
- 製造原価構成：電気代・物流費・人件費の高騰が収益圧迫要因に。
- 賃金インフレ：中小企業が大手との人材獲得競争でコストアップ。
- 価格転嫁力の弱さ：電子部品業界は価格弾力性が小さく、下請け構造の中で価格交渉力が低いため、原価上昇の転嫁が難しい。
- ニッチ経済指標：エネルギー比率が高い部品や、金属レアアース比率の高い製品が特に影響を受けやすい。

【S】社会的要因 (Social)

- 人口動態：技能工・熟練工の高齢化が深刻。若年層の製造業離れと中堅層の人材空洞化。
- 都市と地方：都市部に比べて地方の人材確保が困難。地方移住支援やテレワーク技術導入の促進が鍵。
- Z 世代の価値観：サステナブル・フェアトレード・DEI (多様性・公平性・包括性) への対応が求められる。
- 労働形態の変化：副業・フリーランス・シェアワークの普及により、従来型の雇用モデルでは人材獲得が難化。
- 製造業の社会的イメージ再構築：ロボット・IoT 導入を活用したスマートファクトリ化によって Z 世代の魅力化が急務。

【T】技術的要因（Technological）

- AI・IoT の進化：工程自動化・品質管理・不良品予測に AI 活用が進展。技能継承にもデジタル技術が介在。
- クラウド・エッジコンピューティング：工場データの即時処理による効率化とデータ共有基盤の強化。
- 脱炭素技術：再エネ活用、二酸化炭素排出量管理、環境対応型材料開発へのニーズ増大。
- 他業界からの技術波及：EV、医療機器、宇宙産業などの高度部品ニーズが電子部品製造に革新圧力。
- サイバーセキュリティ：海外との連携がある企業ほど、生産ラインや設計図へのサイバー攻撃リスクが顕在化。

🌐 5 年後（2030 年頃）の仮説シナリオと示唆

- 脱炭素プレッシャーにより、従来の金属素材の使用が制限され、代替素材開発が急進展。
- スマートファクトリー標準化により、従来型設備投資を回避してきた中小企業が生産性格差で淘汰される可能性。
- 量子コンピュータや 6G 基盤開発の進展に伴い、要求される電子部品の精度・信頼性が桁違いに向上。
- 日本国内での製造回帰が一部進むが、技能継承や設備更新が追いつかず「新興国現地生産型」への再転換リスクも。
- 労働力の確保難により、人間中心の製造から AI 中心の設計・製造モデルへ移行。特に「AI 人材による設計最適化」や「無人工場」の概念が浸透。